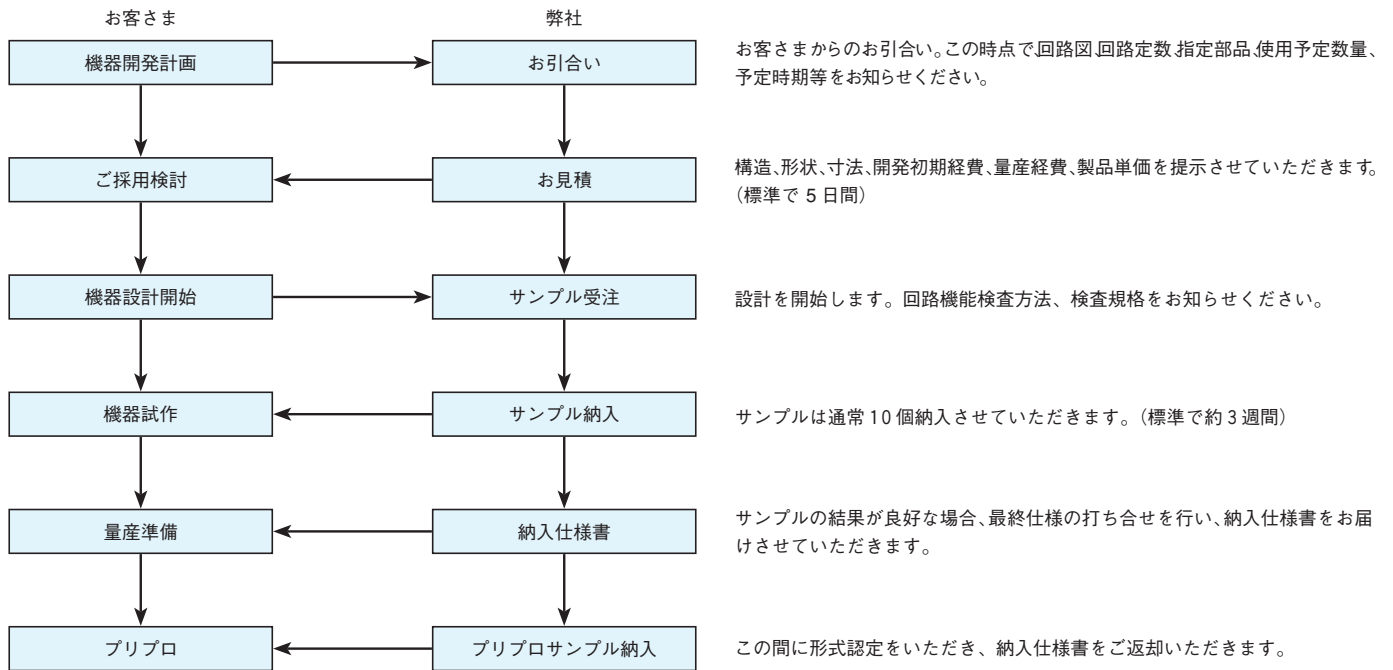


■カスタムモジュールのご案内

お客さまからご提示いただいた回路を目的にあった形状、合理的な構造で、迅速に設計いたします。小形モールド形半導体を使用したタイプ、半導体チップボンディング方法による高密度実装モジュールのいずれにも対応させていただきます。

●開発の手順

カスタムモジュールの開発手順は次の通りです。



●お見積に必要な情報

情報が多いほど、的確なお見積が出来ます。

	最小限必要な情報	必要な情報	お見積精度を高める情報
回路情報	<ul style="list-style-type: none"> ●回路図、回路定数と許容差 ●部品品名、品番、メーカー ●部品の温度特性 (必要なもの) 	<ul style="list-style-type: none"> ●代替部品 ●回路機能のご説明 ●検査仕様 	<ul style="list-style-type: none"> ●周辺回路 ●システム機能
構造情報	<ul style="list-style-type: none"> ●要求形状、寸法 	<ul style="list-style-type: none"> ●ピン配置 ●規格条件 (UL等) ●マーキング仕様 ●外観仕様 	<ul style="list-style-type: none"> ●使用場所周辺のスペース ●装置全体の構造
信頼性情報	<ul style="list-style-type: none"> ●用途 	<ul style="list-style-type: none"> ●使用環境 ●品質保証仕様 ●スクリーニング仕様 	<ul style="list-style-type: none"> ●特別契約の有無
生産情報	<ul style="list-style-type: none"> ●年間ご使用量 ●量産開始時期 	<ul style="list-style-type: none"> ●製品のライフ ●開発計画 ●新規開発・現行製品の別 	<ul style="list-style-type: none"> ●他品番も含めた使用量 ●過去の使用実績

●機密事項

カスタムモジュールはお客様の開発段階から設計に必要な情報をお伺いいたします。そのため当然のことながら、回路に関する機密等、開発に関する機密保持の厳守をお約束させていただきます。